

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司越南工厂一期已满产，海外研发中心、渠道均已布局到位，为切实提高募集资金使用效率，综合考虑内外部形势变化、市场情况及公司实际经营需要，同意将公司2023年发行的全球存托凭证募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目”。变更用途的募集资金截至2026年5月31日共计12,451.82万美元（含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按6.8176，折合人民币84,891.53万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东会审议。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606号），公司获准发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，本次发行GDR 14,339,500份，对应的A股基础股票28,679,000股，每

份 GDR 发行价为 15.00 美元，共计募集资金 21,509.25 万美元，扣除承销费用 116.15 万美元后的募集资金为 21,393.10 万美元，已由主承销商 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED 于 2023 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金账户。另减除上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 181.67 万美元后，公司本次募集资金净额为 21,211.43 万美元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。

## （二）募集资金使用情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司 GDR 募集资金余额为 12,451.82 万美元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额约 2,382.31 万美元），其中存放于募集资金专户的余额为 2,583.82 万美元，使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为 9,868.00 万美元。公司 GDR 募集资金的使用情况如下：

金额单位：万美元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	发展功率元件业务,包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装	12,726.86	12,726.86	4,778.48	37.55% (注 1)	2028 年 12 月 31 日
2	海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设	2,121.14	2,121.14	0	0% (注 1)	2028 年 12 月 31 日
3	补充营运资金及其他一般公司用途	6,363.43	6,363.43	6,363.43	100.00%	—

合计	21,211.43	21,211.43	11,141.91	52.53%	—
----	-----------	-----------	-----------	--------	---

注 1：因资金出境需履行的相关审批流程时间较长以及越南对外商投资的监管政策要求等，为确保“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目和“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目顺利推进，公司前期以自有资金投入部分募投项目建设，目前公司越南工厂一期已实现满产，现有产能已具备一定的海外订单交付能力；海外研发中心、渠道已布局到位，现有海外布局已具备支撑当前国际业务运营的基本能力，可满足现阶段业务需求。

注 2：以上截至 2026 年 5 月 31 日的数据未经审计。

### （三）本次变更募集资金投资项目的概述

为顺应内外部形势变化，结合公司现阶段发展需求，经谨慎研究和论证分析，公司拟对“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，并将上述两个项目合计剩余募集资金 12,451.82 万美元（截至 2026 年 5 月 31 日，含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按 6.8176，折合人民币 84,891.53 万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目”，不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。本次调整是公司优化全球业务布局、将资源更聚焦于境内市场与核心能力建设的重要安排，有利于进一步提升资金使用效率，夯实公司长期稳健发展基础。

变更后，GDR 募集资金使用计划如下：

金额单位：万人民币

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	车规级功率半导体模块封装项目	100,000.00	34,891.53
2	AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目	55,000.00	50,000.00
合计		155,000.00	84,891.53

注：按照 2026 年 5 月 29 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 6.8176 元计算，拟投入募集资金具体金额以实际结转时项目专户资金余额和实际执行时的汇率为准。

公司本次变更部分募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易。本次

变更部分募集资金用途事项尚须提交公司股东会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的理由

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

#### 1、发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装

该项目主要定位于满足海外客户需求，聚焦小信号、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等功率半导体产品，助力公司持续开拓海外市场、完善全球产能布局、提升全球市场核心竞争力。项目募集资金承诺投资总额为 12,726.86 万美元。

公司于 2023 年在越南取得投资许可并启动项目建设，布局海外生产基地。因资金出境需履行的相关审批流程时间较长以及越南对外商投资的监管政策要求等，前期公司以自有资金投入部分项目建设，该项目募集资金使用进度较原计划有所放缓。公司于 2026 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目进行延期，延期后该项目达到预定可使用状态的日期为 2028 年 12 月 31 日。

截至 2026 年 5 月 31 日，“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目已实际使用募集资金 4,778.48 万美元。目前，公司越南工厂已实现一期满产，当前月产能达 12 亿只，专注功率器件和小信号半导体封装产品的研发制造，现有产能具备一定的海外订单交付能力。

#### 2、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设

该项目规划主要服务于公司两项海外核心投资需求，一是海外研发中心基础设施建设、相关设备、软件投入、招聘研发人员、产品研发及测试以及其他开支等；二是持续扩大公司的海外销售网络及售后服务网络的建设，加强海外销售网络的布局，提升海外市场服务能力。项目募集资金承诺投资总额 2,121.14 万美元。

受资金出境审批流程、全球经济环境变化等因素影响，公司前期以自有资金投入海外研发中心及营销网点的建设。公司于 2026 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同

意对“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目进行延期，延期后该项目达到预定可使用状态的日期为2028年12月31日。

截至2026年5月31日，“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目尚未实际使用GDR募集资金。目前，公司已通过自有资金在海外布局研发中心、营销渠道建设，已在全球50多个国家/地区设立了在地化研发与销售网络，其中研发中心7个，具备支撑当前国际业务运营的基本能力，现有海外布局可满足现阶段业务需求。

## （二）变更募投项目的原因

### 1、发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装

该项目系公司2023年度GDR募投项目，项目立项阶段，基于当时半导体行业全球贸易环境、海外功率半导体市场空间广阔的行业背景，结合公司全球化经营布局规划、贴近海外核心客户、优化跨境产能配置的发展考量，公司决定落地越南生产基地，以此夯实海外交付能力、提升全球市场核心竞争力。

截至目前，公司越南工厂一期已实现满产，现有产能具备一定的海外订单交付能力，海外产能布局已达到阶段性规划目标。公司原计划持续推进海外实体产能建设，但结合当前实际情况：一方面，新能源汽车与AI基础设施领域市场快速发展、市场规模持续扩张，叠加国家产业政策扶持，市场发展窗口期宝贵，这亦是公司补齐高端产能、切入高附加值赛道、巩固行业地位、抢抓发展机遇的关键所在，而越南工厂现有产能已能够满足阶段性海外业务需求，相较继续投入海外产能建设，境内项目落地实施的现实必要性与时间紧迫性更为突出；另一方面，鉴于全球贸易环境复杂多变，海外投资面临的不确定性及相关风险溢价显著上升，大规模增加海外产能建设的外部环境较项目立项时已发生较大变化。因此，基于审慎投资原则及对投资者负责的态度，为进一步提升募集资金使用效率，保障募集资金安全、合理运用，结合公司当前发展规划及业务布局优化需要，公司决定变更该募投项目的募集资金用途，并将该项目剩余募集资金投向效益更优、更契合公司长远战略发展方向的项目建设。如后续随着全球经贸环境改善，公司海外业务进一步发展，公司将通过自有资金或自筹资金支持海外扩产需求，确保海外业务的稳健发展。

## 2、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设

该项目系公司 2023 年度 GDR 募投项目，原计划通过建设海外研发中心与全球销售及售后服务网点，实现“研发贴近前沿、服务靠近客户”的双重目标。

目前，公司已通过自有资金将海外研发中心、渠道布局到位，已具备支撑当前国际业务运营的基本能力，现有海外布局可满足现阶段业务需求。当前，全球经济格局深度调整，国际产业资源配置面临新的不确定性，地区技术保护壁垒显著提高，部分国家和地区对半导体领域的技术投资与贸易实施了更为审慎的监管政策，跨境投资与科技合作的不确定性及合规风险增加。与此同时，以人工智能、汽车电子、工业控制及新能源为代表的重点领域呈现结构性增长机遇，对核心工艺、先进设备、产品性能、可靠性和供应链响应速度提出了更高要求。相较于进一步分散资源进行广泛的海外新网点建设，将募集资金更集中地用于投向国内高成长性、高确定性的战略领域，能够更有效地提升资金使用效率、强化核心竞争力，并更快地响应市场需求。

因此，基于优化投资布局的考虑，结合公司当前全球业务布局已取得的阶段性成果，以及对国际环境变化与本土市场机遇的综合研判，公司拟变更该募投项目募集资金用途，并将剩余募集资金用于投向更契合公司长期战略方向、投资回报更明确、更能响应国内重点市场与客户需求的新项目。如后续随着海外业务进一步发展，海外投资环境改善，公司将通过自有资金或自筹资金支持海外研发中心及销售网点建设需求，确保海外业务的稳健发展。

## 三、新募投项目情况说明

### （一）车规级功率半导体模块封装项目

#### 1、新项目的基本情况和投资计划

项目名称：车规级功率半导体模块封装项目

项目实施主体：扬州扬杰电子科技股份有限公司

项目实施地点：江苏扬州维扬经济开发区荷叶西路 6 号东侧、人才驿站西侧

项目建设内容：项目拟新增用地 62 亩，新建办公、生产及辅助用房，总建筑面积约 11.2 万 m<sup>2</sup>。项目购置曝光机、固晶机、键合机、塑封机、测试机、分选机等生产检测设备约 230 台（套）。项目达产后，可形成年产 7,500 万只车规

级功率半导体模块的生产能力。

项目实施周期：2年

项目备案情况：项目已取得江苏扬州维扬经济开发区管理委员会行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：扬维开行审备〔2025〕47号）。

项目投资计划：本项目总投资 100,000.00 万元，其中：建设投资 94,788.08 万元，铺底流动资金 5,211.92 万元，计划使用募集资金 34,891.53 万元（约为 5,117.86 万美元），不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金投入。（注：按照 2026 年 5 月 29 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 6.8176 元计算）

金额单位：万人民币

序号	项目名称	投资额	拟投入募集资金额
1	建设投资	94,788.08	34,891.53
1.1	工程费用	93,453.45	33,827.40
1.1.1	建筑工程费	59,626.05（注）	—
1.1.2	设备购置费（含安装）	33,827.40	33,827.40
1.2	工程建设其他费用	396.13	396.13
1.3	预备费	938.50	668.00
2	铺底流动资金	5,211.92	—
3	总投资	100,000.00	34,891.53

注：建筑工程已于前期以自有资金完成建设。

## 2、项目可行性分析

### （1）项目建设的必要性

#### ①助力新能源汽车行业核心零部件技术升级

MOSFET、IGBT、二极管、晶体管、晶闸管、SiC/GaN 宽禁带半导体等车规级分立器件主要负责电路中的电流控制、电压调节、信号隔离、功率转换以及物理量传感，是汽车电子系统的“肌肉”和“神经末梢”。当前全球新能源汽车产业处于爆发式增长周期，整车及零部件技术不断迭代升级，车辆的性能、安全性、可靠性要求不断提高，对车规级功率半导体形成巨大刚性需求。本项目建成投产

后，将直接匹配新能源汽车行业对 IGBT 模块、MOSFET 等关键功率器件的迫切需求，加速新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）核心部件的国产化替代进程，特别是在车载充电器（OBC）、电机控制器（MCU）、DCDC 转换器等核心场景中，项目产品具备耐高温、抗电磁干扰等优良性能，能够助力新能源汽车关键性能指标的提升及技术的进步。

### ②加快新能源汽车产业链关键环节实现自主可控发展

我国功率半导体行业在高端车规级产品的核心工艺、设备、良率、可靠性等方面持续追赶国际巨头，公司经过多年深度技术研发及大规模制造，已经在部分高端应用领域达到国际先进水平。近年来，随着国际贸易摩擦的持续，下游新能源汽车厂商对功率半导体国产替代的意愿愈发强烈，有利于国产功率半导体产品进入下游客户的供应商体系。本项目通过引进先进的生产检测设备，采用 Shower Power 多流道并联设计、芯片正面 DTS 工艺、芯片背面银烧结工艺以及超声波焊接技术等先进工艺，突破超薄封装、高可靠焊接、高一致性检测等关键技术，达到车规级标准，实现对同类进口产品的替代，降低整车企业采购成本、缩短交付周期。项目建设将提升我国车规级功率半导体行业技术水平和核心竞争力，提升供应链自主可控能力，推动我国功率半导体产业向高端跨越。

### ③企业转型升级、巩固行业龙头地位的核心抓手

公司作为国内功率器件十强企业，在消费电子、工业领域具备显著优势，近年来随着公司经营业绩的不断增长，原有车规级高端产品的产能已无法满足市场需求，制约向新能源汽车、机器人、储能等高附加值市场进一步扩张。本项目通过新增 230 台（套）高端智能装备，生产车规级功率半导体模块，能够满足新能源汽车行业对高可靠性功率器件的严苛标准，推动产品进一步向车规级高端化、小型化、高可靠升级，加快切入头部车企供应链，提升公司在全球功率器件市场份额，进一步巩固公司在功率半导体行业的市场地位。

## （2）项目的可行性

### ①国家相关政策的支持

近年来，国家高度重视半导体产业链安全，持续出台一系列支持集成电路产

业发展的政策措施。对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》等指导文件，本项目引进先进生产检测设备，扩大车规级功率半导体生产能力，属于重点支持的新型电子元器件制造范畴，项目实施具备良好的政策环境。

### ②公司具有较好的建设基础

公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，是国内少数集晶圆制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，产品在诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。公司于 2018 年开始投入车规级产品的开发和生产，已具备从设计、芯片制造到封装测试的车规级产品 IDM 产业化能力，2025 年，公司车规级产品销售收入达 10.93 亿元，得到了下游市场的充分认可。本次建设是在公司已有技术及产能的基础上，进一步结合市场需求进行提升，以服务中高端市场需求。

### ③广阔的市场空间为项目建设提供强有力的保障

功率半导体是电力电子技术的基础，也是构成电力电子转换装置的核心器件，应用范围覆盖 AI 数据中心、新能源汽车、智能电网、工业控制、光伏等领域。根据 Omdia 数据，2025 年，全球功率半导体市场规模达到 545 亿美元，其中车规级产品市场约 150 亿美元。随着新能源汽车市场渗透率的不断提升，车规级功率半导体有望维持较高的复合增长率，下游市场空间广阔。目前，公司已取得多家国际标杆汽车整车厂和 Tier1 客户认证，技术方案和产品性能获得多家主流客户认可，能够保障本项目新增产能的顺利消化。

### （3）项目建设经济效益

经公司初步测算，本项目达产后预计年营业收入为 120,000.00 万元，项目投资财务内部收益率所得税后为 21.27%；项目所得税后投资回收期为 5.87 年（含建设期 2 年），项目经济效益较好。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任，请投资者予以关注。

## （二）AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目

### 1、新项目的基本情况和投资计划

项目名称：AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目

项目实施主体：扬州扬杰电子科技股份有限公司

项目实施地点：江苏扬州维扬经济开发区新甘泉路68号

项目建设内容：项目采用先进的全自动固晶共晶技术、铜线球焊技术、Auto-Molding塑封技术、AI智能3D检测技术等生产工艺技术，对现有约40,000平方米厂房进行适应性改造，引进高精度芯片划片机、固晶机、焊线机、全自动注塑压机、切筋机、测试包装一体机等国内外先进生产设备和公辅设备，对小信号功率半导体生产线进行技术改造。改造完成后，可新增190亿只FBP系列、SOD系列、SOT系列小信号功率半导体器件的生产能力，产品主要用于AI算力中心和数据中心的电源管理、信号链、驱动/接口、保护与控制等，合计具备年产620亿只小信号功率半导体器件的生产能力。

项目实施周期：2年

项目备案情况：公司将按照项目建设进度、监管要求履行审批或备案程序。

项目投资计划：本项目总投资55,000.00万元，其中：建设投资49,770.87万元，铺底流动资金5,229.13万元，计划使用募集资金50,000.00万元（约为7,333.96万美元），不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金投入。（注：按照2026年5月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8176元计算）

金额单位：万人民币

序号	项目名称	投资额	拟投入募集资金额
1	建设投资	49,770.87	49,770.87
1.1	工程费用	48,331.46	48,331.46
1.1.1	建筑工程费	2,054.60	2,054.60
1.1.2	设备购置费（含安装）	46,276.86	46,276.86
1.2	工程建设其他费用	703.88	703.88
1.3	预备费	735.53	735.53

2	铺底流动资金	5,229.13	229.13
3	总投资	55,000.00	50,000.00

## 2、项目可行性分析

### (1) 项目建设的必要性

#### ①有利于替代进口，带动我国功率半导体产业的发展

经过多年的发展，我国已成为电子信息生产大国，同时也是全球最大的半导体消费国，但与国外先进水平相比，我国高端功率半导体产品市场仍被英飞凌、安森美等国际龙头主导，进口可替代空间巨大。近年来，随着国际贸易摩擦的持续，AI 基础设施、智能终端、消费电子等领域下游国产厂商对功率半导体国产替代的意愿愈发强烈，有利于国产功率半导体厂商进入下游客户的产品验证体系。本项目对小信号功率半导体生产线进行技术改造，生产 AI 基础设施用高性能小信号功率半导体器件，能够有效替代进口，为下游企业提供高质量、高可靠性的小信号产品。项目建设有利于提升我国小信号功率半导体行业的技术水平和核心竞争力，扩大高端小信号功率器件产品国产化市场份额。

#### ②有利于解决产能瓶颈问题，满足下游 AI 基础设施市场需求

小信号功率器件包括小电流/低功率 ( $\leq 1A/\leq 1W$ ) MOSFET、二极管、三极管等，在 AI 基础设施的电源管理、信号链、驱动/接口、保护与控制等场景均有着广泛应用，在云端主要提升电源效率与保护，端侧可实现感知、驱动与低功耗管理，是 AI 硬件设施的“神经末梢”。近年来，随着 AI 技术的快速升级，从算力中心、数据中心等基础设施到具身智能、智能终端等 AI 应用得到了快速发展，对功率器件提出了小尺寸、高频、低损耗、高可靠等核心需求。公司现有小信号系列产品的年产能约 430 亿只，已难以满足市场供应。本项目将在扬州维扬经济开发区公司现有厂区内对小信号产线进行升级改造，购进先进的生产及精密检测设备，提高生产效率，有效解决公司现有小信号系列产品的产能瓶颈问题，显著提升产品的生产能力和交付能力，为公司小信号产品在 AI 基础设施领域业务的持续拓展打下坚实的基础。

#### ③有利于提升企业核心竞争力

随着下游 AI 基础设施、智能终端等应用市场的不断升级，对功率半导体产

品提出了更高的性能要求，公司的产品结构也需要根据市场需求不断优化升级。通过本项目的实施，采用先进的全自动固晶共晶技术、铜线球焊技术、Auto-Molding 塑封技术、AI 智能 3D 检测技术等，进一步提升小信号产品的性能参数，扩大小信号产品的产能和良率，优化小信号系列产品结构，显著提升自身核心竞争力，更好地应对市场竞争，满足下游 AI 基础设施等重点市场不断增长的需求，实现公司可持续发展。

## （2）项目的可行性

### ①国家相关政策的支持

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，功率半导体作为电子产品的关键部件，是电子信息产业中承上启下且最为活跃组成部分之一。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等均鼓励功率半导体企业大胆创新，推动功率半导体产业发展进程不断加快。《国民经济和社会发展的第十五个五年规划纲要》《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028 年）》等政策文件均提出要优化算力设施部署、夯实人工智能发展底座。本项目新增产能主要面向 AI 基础设施市场，项目实施与国家政策导向高度契合，政策环境成熟。

### ②公司具有较好的建设基础

公司于 2017 年开始投入小信号产品的建设，目前小信号产品已具备从设计、芯片制造到封装测试的 IDM 产业化能力。经过多年发展，公司已形成较大规模的小信号产品生产及销售能力，2025 年，公司销售小信号各类产品收入 12.26 亿元，覆盖 45 种类别产品。本项目建设是在公司已有技术及产能的基础上，进一步结合下游 AI 基础设施市场需求进行提升，项目技术路线成熟有保障。

同时，公司建有一支覆盖高端芯片研发设计、先进功率半导体晶圆制造、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍，引进了一批业界工作超过 20 年的资深技术专家和博士，其中包括省部级“双创计划”创新创业领军人才、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师、江苏省 333 人才、江苏省六大高峰人才等。公司先后承担国家火炬计划 2 项，国家创新基金 2 项，累计获得授权专利超过 719 件，其中发明专利超过 120 件，软件著作 8 件。深厚的技术积累及专业的

人才队伍为项目提供了技术支撑。

### ③建设条件成熟、方案可行

项目利用现有 40,000 平方米厂房，无需新增用地，投资效率高。项目新增先进的高精度芯片划片机、固晶机、焊线机、全自动注塑压机、切筋机、测试包装一体机等，技术成熟、良率稳定、智能化程度高，工艺方案经过行业验证，可快速实现产能爬坡。水电气、动力、环保等公用工程依托现有厂区，配套完善，无需新增大额投资。项目从设备采购、安装、调试到试生产全流程可控，技术、建设、环保风险低，实施条件成熟。

### (3) 项目建设经济效益

经公司初步测算，本项目达产后预计年营业收入为 108,300.00 万元，项目投资财务内部收益率所得税后为 29.89%；项目所得税后投资回收期为 4.93 年（含建设期 2 年），项目经济效益较好。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

## 四、项目风险及应对措施

### (一) 审批风险

公司本次变更募投项目事项尚待股东会审议通过后方可实施，存在审批风险。

### (二) 项目前景、效益等不能达到预期的风险

项目实施过程中，公司面临着产业政策及市场景气度变化等诸多不确定因素，如果募投项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，将产生项目效益可能达不到预期的风险。

### (三) 项目组织实施风险

项目在建设及后续运营过程中受到宏观经济、产业政策、市场环境等诸多因素的影响，如出现宏观政策调整、市场环境恶化、下游应用场景发生重大变化、项目实施条件变化等因素，可能导致项目实施进度不及预期，进而存在项目延期、

变更、中止或终止无法实施的风险。

#### **（四）风险应对措施**

公司将密切关注政策变化和市场动态，坚持审慎投资、稳健经营原则，根据行业动态及公司实际经营情况动态优化募投项目建设节奏与投资安排，同时加强对项目的监督检查和评估，做好各项资源的组织协调及调度工作，以最大程度降低有关风险事项对新项目顺利实施的不利影响。

#### **五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响**

公司本次变更募集资金投资项目事项是为了提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略规划及当前面临的市场环境，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

#### **六、审议程序及相关意见**

##### **（一）董事会审计委员会意见**

2026年6月15日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，审计委员会认为：本次变更部分募集资金投资项目事项是公司根据自身发展及实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司中长期战略规划，有利于推动公司战略落地和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，审计委员会同意将公司2023年发行的全球存托凭证募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金用于实施公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目”，同意将本议案提交董事会审议。

## （二）董事会意见

2026年6月15日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司越南工厂一期已满产，海外研发中心、渠道均已布局到位，为切实提高募集资金使用效率，综合考虑内外部形势变化、市场情况及公司实际经营需要，同意将公司2023年发行的全球存托凭证募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目”。变更用途的募集资金截至2026年5月31日共计12,451.82万美元（含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按6.8176，折合人民币84,891.53万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月16日